

秉持真诚、包容、永续经营的理念，
构建客户、员工、公司共同发展的平台

产品是企业的形象，质量是企业的信誉

正品保证，优质服务

CKSC

深圳市俊基瑞祥科技有限公司

SHENZHEN CHUN KEI SHUI CHEUNG TECHNOLOGY CO., LTD

深圳市俊基瑞祥科技有限公司上海分公司

SHENZHEN CHUN KEI SHUI CHEUNG TECHNOLOGY CO., LTD SHANGHAI BRANCH

俊基瑞祥(香港)科技有限公司

CHUN KEI SHUI CHEUNG (HK) TECHNOLOGY LIMITED



深圳俊基瑞祥科技有限公司是一家专注于焊锡制品材料领域的公司，专业代理销售水溶性锡膏、助焊膏、无铅及有铅系列焊锡膏、锡条、锡线、配套液体助焊剂以及电子工业清洗剂等国内外知名品牌产品；不断为电子、汽车等各种产业领域提供着不可或缺的锡制材料。

公司座落在交通便利的地铁9号线人民南站旁边，临近国贸、东门商圈与罗湖口岸。为清洗剂领航者德国ZESTRON正式授权的合作伙伴，也为日本SANWA三和化学制品公司、新加坡雅拓莱金属制品公司、韩国ECOJOIN焊锡生产厂家、中国YIKST亿铍达焊锡工业以美国MS2还原剂在大陆的合作公司，同时也是日本SOLDER COAT焊锡公司国内唯一的合作伙伴。负责中国大陆销售、技术支持。

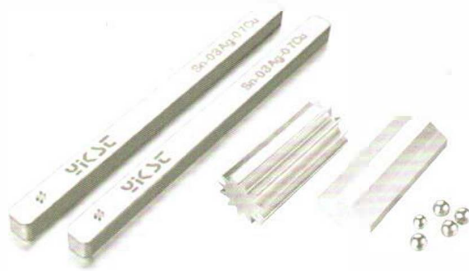
公司经销焊锡制品以及清洗剂品牌简介：

- ★德国ZESTRON电子清洗剂:行业领先的电子业清洗剂 满足各类清洗需求
 - ★日本SANWA(三和)化学制品公司:主要制作水溶性助焊膏、水溶性锡膏和无铅焊膏
 - ★中国YIKST亿铍达焊锡工业公司: 研制、生产、销售电子焊接材料的专业厂家，主要生产无铅及有铅系列焊锡膏、锡条、锡丝及配套液体助焊剂
 - ★日本SOLDER COAT(首达高焊锡公司): 日本焊锡品牌中价优且品质最稳当的产品，主要产品有锡膏、锡条、锡线
 - ★韩国ECOJOIN焊锡生产厂家:专业从事研发、生产无铅、无卤锡制品，产品涵盖锡膏、锡条、锡线、银浆、5号粉锡膏、助焊剂等产品
 - ★新加坡雅拓莱金属制品公司:专业生产和销售锡条、锡线、阳极棒、阳极球、助焊剂、锡膏，是一家综合性的电子辅料生产厂商
 - ★美国MS2还原剂: 还原率高达85-90%，并对焊锡表面形成一层抗氧化层，适用于各种合金的锡条
- 我司秉承着诚信经营，永续发展的理念，将竭诚为客户提供专业，周到的服务！



低银化无铅焊料产业实用化的倡导者与先行者

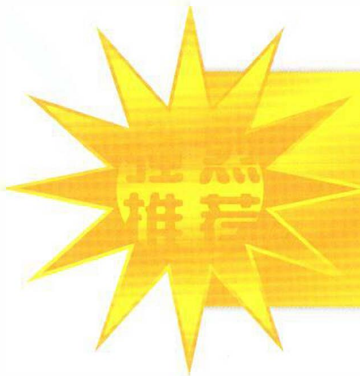
Advocator and pioneer for the application of SAC solder with low-silver content



独有的PURIFY合金处理工艺
 有效去除金属原料中天然形成的氧化物
 专利的ANTI-OXIDATION工艺
 进一步提高锡条的抗氧化能力
 Exclusive PURIFY alloy process to effectively
 remove natural oxides in the raw materials
 Patented ANTI-OXIDATION process to further
 improves the anti-oxidation ability of solder bars



新型连铸工艺保证挤压筒的零缺陷
 专业生产细线径药芯锡线, 最小可至0.15mm
 科学的助焊剂配方保证优异的可焊性
 Latest continuous skills ensures zero defect in extrusion cylinders
 Minimum diameter of solder wire down to 0.15mm
 Scientific flux composition to ensure the excellent solderability



强烈推荐 Strongly recommended:

性价比最高的无铅焊料合金 M507: Sn-0.5Ag-0.7Cu合金
 The most cost effective lead-free solder M507: Sn-0.5Ag-0.7Cu Alloy

技术背景 Technical Background

- 中国发明专利 ZL03 1 10895.4
- 广东省部产学研项目 2008A080403008
- 粤港招标项目 2008A092000007
- China invention patent ZL 03 1 10895.4
- Guangdong Province R&D Project: 2008A080403008
- Guangdong-HongKong Tender Project: 2008A092000007



Lead-free Solder 无铅焊锡



无铅焊料合金种类及供应形态

Lead-Free Solder Alloy Types and Forms 可供供应产品形式 Available product form

合金成份 (wt.%) Composition (wt.%)	熔点 (°C) Melting Point (°C)	锡膏 Solder Paste	锡条 Solder Bar	锡线 Solder Wire	备注 Remark
Sn-0.7Cu	227		●	●	
Sn-0.7Cu-0.05Ni	227-230		●	●	[1]
Sn-3.0Cu/4.0Cu	227-300/320		●	●	
Sn99.9	232		●	●	
Sn-0.3Ag-0.7Cu	217-223	●	●	●	
Sn-0.5Ag-0.7Cu	217-227		●	●	[2]
Sn-1.0Ag-0.5Cu	217-221	●	●	●	[2]
Sn-3.0Ag-0.5Cu	217	●	●	●	[2],[3]
Sn-55b	235-240	●	●	●	
Sn-10Sb-5Cu	240-250		●	●	
Sn-58Bi	138	●	●	●	
Sn-30.0Bi-0.5Cu	170-185	●			
Sn-57.6Bi-0.4Ag	138-154	●			
Sn-57.0Bi-1.0Ag	138-143	●			
Sn-35.0Bi-1.0Ag	151-189	●			
Sn-8.0Zn-3.0Bi	187-197	●			

[1]中国发明专利 China Paten:ZL 03 1 11446.6;

[2]中国发明专利 China Paten:ZL 03 1 10895.4;

[3]美国发明专利 US Paten:5527628

有铅焊料合金种类及供应形态

Lead-Containing Solder Alloy Types and Forms 可供供应产品形式 Available product form

合金成份 (wt.%) Composition (wt.%)	熔点 (°C) Melting Point (°C)	锡膏 Solder Paste	锡条 Solder Bar	锡线 Solder Wire	备注 Remark
63Sn-37Pb	183	●	●	●	
60Sn-40Pb	183-191	●	●	●	
55Sn-45Pb	183-200	●	●	●	
50Sn-50Pb	183-216		●	●	
45Sn-55Pb	183-226		●	●	
40Sn-60Pb	183-238		●	●	
35Sn-65Pb	183-246		●	●	
30Sn-70Pb	183-254		●	●	
25Sn-75Pb	183-268		●	●	
20Sn-80Pb	183-280		●	●	
15Sn-85Pb	183-288		●	●	
10Sn-90Pb	275-302		●	●	
5Sn-95Pb	308-312	●	●	●	
62Sn-36Pb-2Ag	179	●	●	●	
63Sn-36.6Pb-0.4Ag	183-190	●	●	●	
63Sn-36.8Pb-0.2Ag	183-188	●	●	●	
5Sn-92.5Pb-2.5Ag	287-296	●	●	●	
43Sn-43Pb-14Bi	144-163	●			

注：我司备有其他特殊成分焊料，详情请向我司咨询

深圳市俊基瑞祥科技有限公司 (0755-82282821/0755-82281981)

深圳市俊基瑞祥科技有限公司上海分公司 (021-60765250/021-60765253)

俊基瑞祥(香港)科技有限公司 (852-81005996)

N.B.Other lead-free or lead-containtin solder alloys with special compositions are available.Please inquire for details.

还可加工成阳极棒及锡球等形态供电镀行业使用

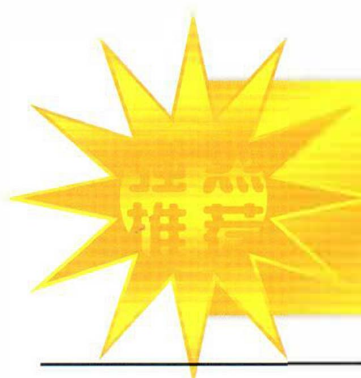
Also available in the form of anode rod and solder balls fo electroplating industry



与时俱进的专业研发团队
 Professional R&D team which keeps improving
 自动化生产系统确保品质稳定
 Automatic manufacturing system to maintain stable quality
 多元化配方技术适应不同需求
 Diversified formulations for various applications



SUPER105:Sn-1.0Ag-0.5Cu



强烈推荐 Strongly recommended:

高性价比无铅锡膏用合金成份
 Cost effective alloy composition for lead-free pastes

锡膏用合金成份

型号/Type	合金成份/Alloy	粉末粒度/Powder size
FLY905-T	Sn-3.8Ag-0.7Cu	Type 3/Type 4/Type 5
FLY905/905-CW	Sn-3.0Ag-0.5Cu	
SUPER105	Sn-1.0Ag-0.5Cu	Type 3/Type 4/Type 5
SUPER0307	Sn-0.3Ag-0.7Cu	
FLY301	Sn-58Bi	
FLY401	Sn-30Bi-0.5Cu	Type 2/Type 2.5/Type 3/Type 4
FLY501/502/503/504	Sn-Bi-Ag	
FLY601/602/603	Sn-Pb-Ag	
FLY701/702/703	Sn-Pb-Bi	Type 3/Type 4/Type 5
FLY801/802/803	Sn-Pb	

注：我司还备有其他粉末粒度及特殊配方的锡膏产品供客户选择，详情请向我司咨询
 深圳市俊基瑞祥科技有限公司 (0755-82282821/0755-82281981)
 深圳市俊基瑞祥科技有限公司上海分公司 (021-60765250/021-60765253)
 俊基瑞祥(香港)科技有限公司 (852-81005996)

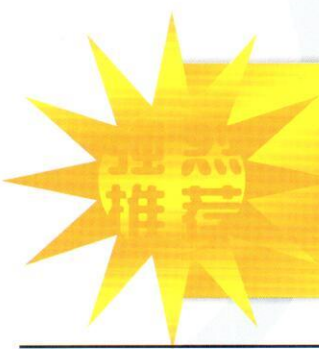
N.B. Other solder pastes of special powder sizes or formulations available. Please inquire for details

No-Clean Solder Paste 免清洗锡膏





业界清洗剂的领航者



强烈推荐 **ZESTRON**
 High Precision Cleaning
 业界清洗剂的领航者 总有最适合您的设备和清洗剂



SC200

水基清洗剂

- 钢网清洗的首选产品
- 无闪点，使用寿命长
- 与钢网材料兼容性好，操作安全，不含卤素



SP200

水基型清洗剂

- 极具性价比的维护保养的清洗剂
- 无闪点，去除助焊剂能力强
- 材料兼容性好，操作安全，不含卤素



RC303

水基型清洗剂

- 新一代回流炉和波峰焊设备维护保养的水基清洗剂
- 无闪点，低气味
- 操作简易且安全，不含卤素

其他清洗 PCBA，半导体封装和功率电子的清洗剂如：

A 201, WS 400, N 600, SE 220, PE 180...

详情请咨询 深圳市俊基瑞祥科技有限公司 (0755-82282821/0755-82281981)

深圳市俊基瑞祥科技有限公司上海分公司 (021-60765250/021-60765253)

俊基瑞祥(香港)科技有限公司 (852-81005996)





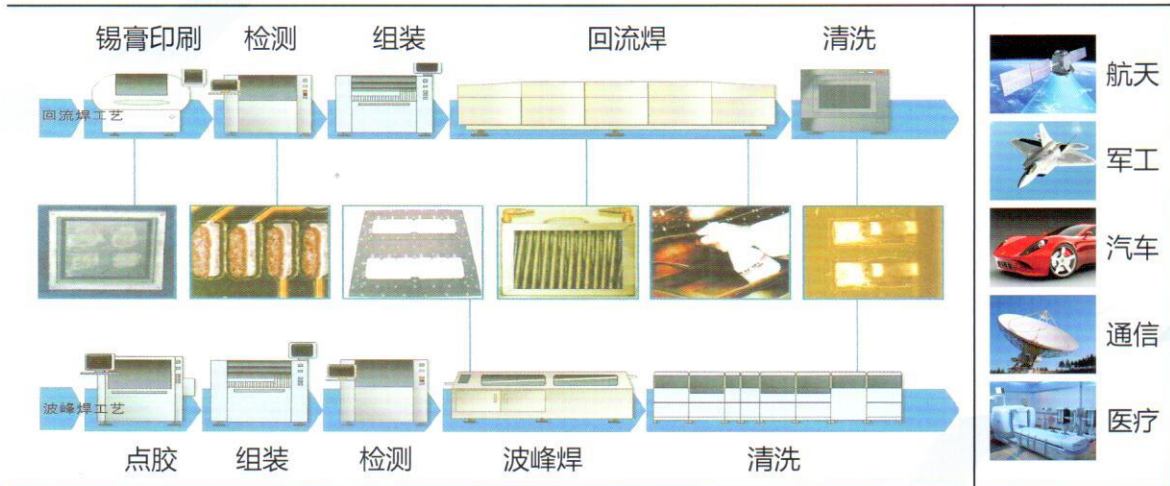
电子产业的清洗应用

电子工业主要清洗应用的产品推荐

欢迎来到ZESTRON欧洲、美国和亚洲的技术中心选取最适合您的设备和清洗剂：

- ▶ 拥有全球最多种类的国际主流厂商制造的喷淋、超声和喷流设备
- ▶ 由本地工艺工程师提供的有针对性的公允建议
- ▶ 依据国际标准检测清洗结果

短短一天您就能全面了解并找到解决方案——完全免费



	基材	污染物	清洗剂		
			溶剂型	水基MPC®	水性碱基FAST®
1	大功率封装 芯片粘接基材 晶圆植球 BGA	粘性助焊剂 有铅锡膏	ZESTRON®VD ZESTRON®FA + ZESTRON®CO150	VIGON®A201 VIGON®A250 VIGON®N600 VIGON®US	ATRON®AC205 ATRON®AC207
2	网版, 丝网	焊锡膏 贴片胶	ZESTRON®SD100 ZESTRON®SD300 ZESTRON®SD301 ZESTRON®SW	VIGON®SC200 VIGON®SC202 VIGON®SC210 VIGON®FD150 VIGON®SC VIGON®UC160	ATRON®SP200
3	点胶针头	贴片胶	ZESTRON®HC ZESTRON®ES200	--	--
4	误印电路板	焊锡膏 贴片胶	ZESTRON®SD100 ZESTRON®SD300 ZESTRON®SD301	VIGON®SC200 VIGON®SC202 VIGON®SC210 VIGON®FD150 VIGON®SC	--
5	焊接夹具 回流炉 冷凝回收	烘烤过的助焊剂	--	VIGON®RC101	ATRON®SP200 ATRON®SP300 ATRON®SP400
6	电子组装件	助焊剂残留物	ZESTRON®FA + ZESTRON®VD ZESTRON®CO150	VIGON®A201 VIGON®A250 VIGON®N600 VIGON®US	ATRON®AC205 ATRON®AC207





含松香的焊锡线 Flux Cored Solder



新开发的含松香焊锡拥有超凡的操作性及可靠性
 Newly developed flux exceptional workability and reliability

含松香的焊锡线产品一览 Flux Cored Solder line-up

产品名称 Products	型号 Type	卤素含量 Hologen Content(wt%)	铜板腐蚀试验 Copper corrosion test	绝缘电阻值 Insulation resistance(Ω)	扩散率 Spreading factor(%)	主要特征 Features	线径 Diameter(mm)	重量 Weight
ARA	RA	< 0.4	合格 Pass	> 5.0×10 ⁹	> 75	通用型号 General purpose	0.1~1.6	1kg
GR	RMA	< 0.1	合格 Pass	> 1.0×10 ⁹	> 75	高可靠性 High reliability		·
GR-III	RA	< 0.4	合格 Pass	> 1.0×10 ⁹	> 80	提高瞬间润湿性 Improved instantaneous watability		500g
GR-III (M)	RA	< 0.4	合格 Pass	> 1.0×10 ⁹	> 75	降低飞溅 Reduces flux splash		·
XFC	RMA	检测下限*1 Lower limit of detection	合格 Pass	> 5.0×10 ⁹	> 75	不含卤素 Halogen-free		250g

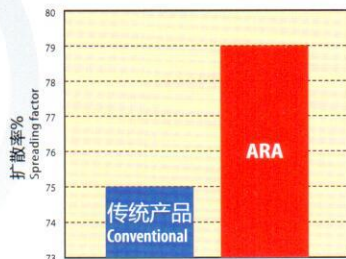
*1: 燃烧-离子色谱法 Combustion-Ion Chromatography

含松香焊锡标准 Stand flux cored solder ARA

具有优良的操作性，减少焊头的交换次数

The frequency of soldering tip changing is low owing to excellent workability.

◎ 扩散试验
Spreading test



◎ 焊头腐蚀试验 (焊接10000次后的焊头腐蚀状况)
Erosion of soldering tip test (Erosion of tip after 10000 shots)

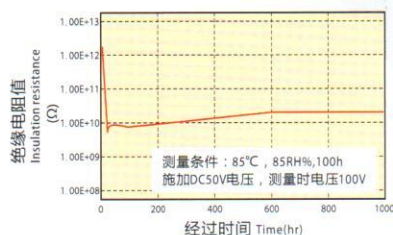


高可靠性 High reliability GR

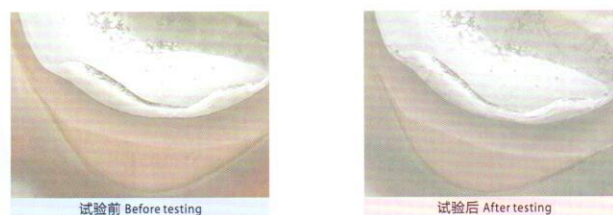
这种含松香焊锡可抑制电迁移和铜腐蚀的发生，提高可靠性。

Inceased reliability flux cored solder that supresses the occurrence of migration and coper corrosion.

◎ 电迁移试验
Electromigration test



◎ 铜板腐蚀试验
Copper corrosion test





焊锡合金产品 Solder Alloy

可在所有温度区域使用的无铅焊锡合金 All temperature range lead-free solder alloy

焊锡合金产品一览 Solder Alloy line-up

● 标准品 A standard product ● 定制品 Available by request

产品名称 Products	熔融温度 Temp.(°C)		形状 Form					合金成份 Alloy composition
	固相线 Solidus temp.	液相线 Liquidus temp.	棒 Bar	焊锡膏 Paste	含松香线 Flux cored	线 Wire	BGA球 Ball	
高温 High-Temp.	LLS 385	385		●			●	Zn-Al
	LLS 380	199	340~370	●			●	Sn-Zn-Cu-Ni
	LLS 375	217	375	●				Sn-Ag-Cu
	LLS 257	217	330	●			●	Sn-Ag-Cu
	LLS 255	227	335	●		●	●	Sn-Cu
	LLS 250	227	310	●		●	●	Sn-Cu
	LLS 240	235	240	●	●		●	Sn-Sb
中温 Middle-Temp.	LLS 227	227		●		●	●	Sn-Cu
	LLS 227N※1	227		●	●	●	●	Sn-Cu-Ni-Ge
	LLS 227α※1	227		●	●	●	●	Sn-Ag-Cu-Ni-Ge
	LLS 227L	227		●		●	●	Sn-Cu-X
	LLS 225	217	227	●	●	●	●	Sn-Ag-Cu
	LLS 221	221		●	●	●	●	Sn-Ag
	LLS 220	217	222	●		●	●	Sn-Ag-Cu
	LLS 220α※2	217	223	●		●	●	Sn-Ag-Cu-Ni-Ge
	LLS 219※3	217	219	●	●	●	●	Sn-Ag-Cu
	LLS 219L※4	217	219	●		●	●	Sn-Ag-Cu-X
	LLS 219α※2	217	220	●	●	●	●	Sn-Ag-Cu-Ni-Ge
	LLS 219β※5	214	216	●	●	●	●	Sn-Ag-Cu-Ni-In
	LLS 217	217		●	●	●	●	Sn-Ag-Cu
	LLS 217α※2	217	219	●		●	●	Sn-Ag-Cu-Ni-Ge
	LLS 215	202	214	●		●	●	Sn-Ag-Cu-Bi-In
	LLS 210	207	213	●	●	●	●	Sn-Ag-Cu-In
	LLS 199	199		●		●	●	Sn-Zn
LLS 198※6	198	200	●		●	●	Sn-Ag-Al	
LLS 195	195	197	●		●	●	Sn-Zn-Bi	
LLS 190	191	196	●		●	●	Sn-Zn-Bi	
低温 Low-Temp.	LLS 140	138	170	●	●	●	●	Sn-Bi-CU
	LLS 138	138		●		●	●	Sn-Bi
	LLS 109	100	109	●		●	●	Sn-Bi-In
	LLS 78	78	81	●		●	●	Sn-Bi-In

※授权产品 Licensed products

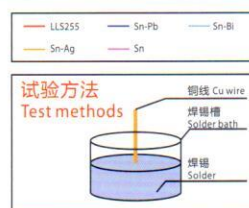
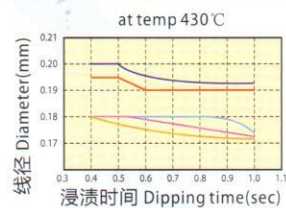
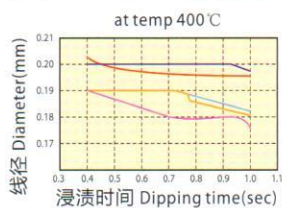
※1: JP PAT No.3152945 etc. ※2: JP PAT No.3296289/US PAT No.6179935B1
 ※3 JP PAT No.3027441/US PAT No.5527628 ※4: JP PAT No.3599101
 ※5 JP PAT No.3776361 etc. ※6 JP PAT No.3357045 ※7 JP PAT NO.4135268

高温 High-Temp. LLS 255

在所有温度区域铜的腐蚀量与、SN-Pb等同或更低。

At all temperatures, the copper corrosion amount is equal to or less than that of Sn-Pb.

◎铜腐蚀量比较 Comparison of copper corrosion amount



适用制品例子 (铜线)
Example of application (Copper wire)





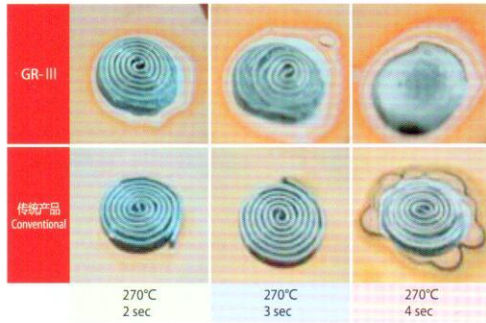
优越的瞬间润湿性 Superior instantaneous wettability GR-III

缩短开始熔化所需的时间，既抑制电迁移又提高操作性和可靠性。

Reduces the time until the start of melting and also suppresses migration, thus offering both workability and reliability.

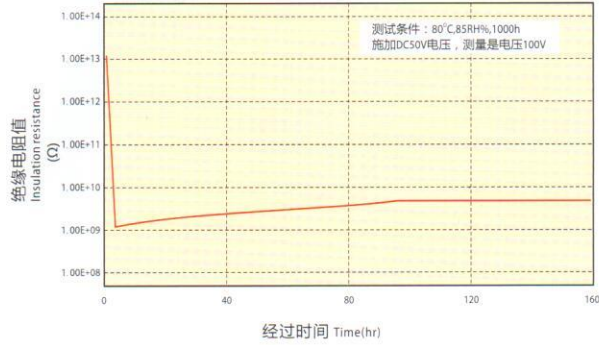
瞬间润湿性试验

Instantaneous wettability test



电迁移试验

Electromigration test



降低飞散 Reduces flux splash GR-III (M)

大幅降低助焊剂飞散的含松香焊锡。

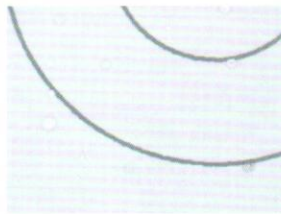
Flux cored solder with significantly reduced flux splash.

飞散试验

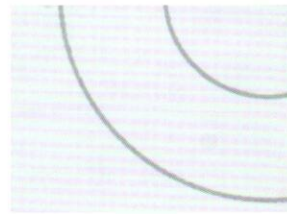
Splash test



A点的飞散状况
 Splash condition at point A



B点的飞散状况
 Splash condition at point B



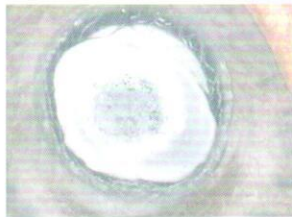
不含卤素 Halogen-free XFC

尽管不含卤素，却具有优越的润湿性。

Offers superior wettability even while being halogen-free.

扩散性试验

Spreading test



扩散率 Spreading factor:71%
 传统产品 Conventional



扩散率 Spreading factor:75%
 XFC

无卤的定义

氯 (Cl) 含量 ≤900ppm
 溴 (Br) 含量 : ≤900ppm
 氯溴总含量 : ≤1500ppm
 (燃烧-离子色谱法)

Definition of Halogen-free

Chlorine content: ≤900ppm
 Bromine content: ≤900ppm
 Combined chlorine and bromine content: ≤1500ppm
 (Combustion-Ion Chromatography)



低成本 Lost cost LLS 225·LLS 227·LLS 227N·LLS227L

既发挥与SAC305同等的性能，而成本与SAC305相比大约可降低20~40%
Cost can be reduced by approx.20% to 40% when compared to SAC 305.

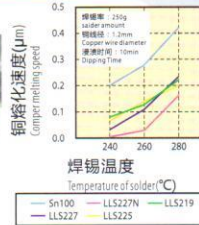
产品名称 Products	合金成份 Alloy composition					强度 strength(Mpa)	伸长 Elongation(%)	成本比较 Comparison of cost
	Sn	Ag	Cu	Ni	Ge			
LLS 219(SAC305)	Bal.	3	0.5	-	-	39.7	74	1
LLS 225	Bal.	0.3	0.7	-	-	34.6	55	0.65
LLS 227	Bal.	-	0.7	-	-	29	53	0.6
LLS 227N※1	Bal.	-	0.6	0.05	0.01	30	58	0.62
LLS 227L	Bal.	0.12	0.7	0.05	≤0.01	30.1	60	0.63

※1:从日本斯倍利亚股份有限公司获得授权
Licensed by NIHON SUPERIOR CO.,LTD

流动性~润湿性比较~
Comparison of flow character~wettability~



铜熔化速度
Copper melting speed



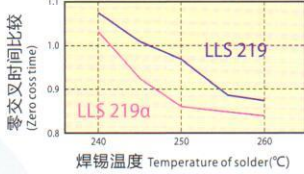
低不良率与高可靠性 Defective rate decrease/High reliability LLS 219α

LLS 219α是直接继承具有优越性能的LLS 219的使用条件并进一步提高了“润湿性”和“耐热疲劳性”的合金。

The LLS 219α is an alloy with further improved wettability and heat-cycle resistance properties, and that inherits the superlative performance of the LLS 219.

提高润湿性「零交叉时间比较」

Improvement of wettability [Comparison of zero cross time]



提高耐热疲劳性 [QFP 拉伸强度比较 / 40~125°C]

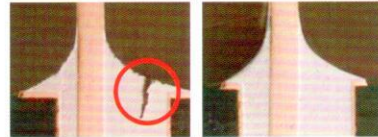
Improvement in heat-cycle resistance [Comparison of tensile strength]



减少缩孔

Reducing shrinkage cavity

LLS 219 LLS 219α



超长寿命 Super long life LLS219β

抑制焊盘中的铜与焊锡合中的锡生成化合物，获得了高可靠性。

Generation of inter-metallic compounds from the copper in the land and solder alloy tin is minimized, thus achieving higher reliability.

锡焊部位的冷热循环试验 2000循环 cycles

Thermal cycle test of soldering part

-40°C×30min ↔ 125°C×30min(每个循环 per cycle)



LLS 219

LLS 219β

润湿性

Wettability

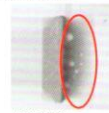


LLS 219

LLS 219β

空洞出现

Occurs of void



LLS 219

以X线观察

X-ray observations



LLS 219β

超塑性、低熔点 Super ductile/Low melting LLS 140

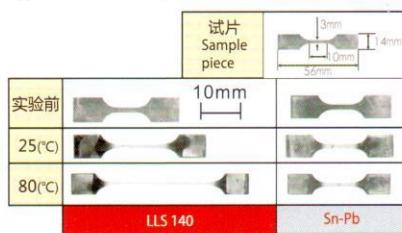
属于超塑性合金，与Sn-Pb相比，强度是其1.5倍以上、延展性是其2.5倍。

Over 1.5 times better strength 2.5 times better elongation than Sn-Pb.

拉伸试验

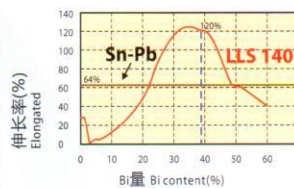
Tensile test

25°C和80°C时拉伸试验的试片外观照片
Appearance of the test specimen at 25°C and 80°C



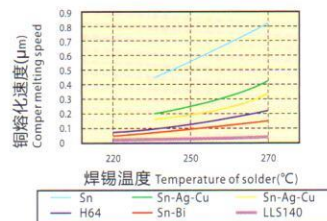
伸长特性

Elongated character



铜熔化速度

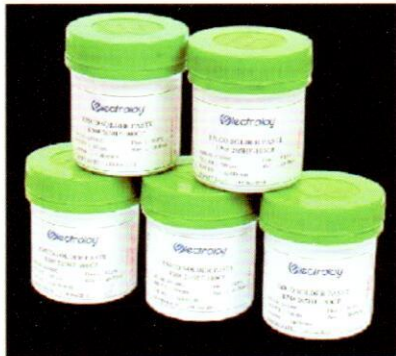
Copper melting speed





PRODUCT SELECTION GUIDE 产品选择向导

- Electroloy offer a wide range of lead free wires with different cored flux types and flux % of range 2-6%. Suitable for manual and robotic soldering application. We also manufacture lead free wires of diameters up to 0.15mm to suit different types of soldering applications.
- At Electroloy, we can also customize alloy for your application for use in conventional hand soldering to auto robotic & plumbing application.
- 雅拓来提供一系列的无铅锡线，助焊剂类型多种多样，而助焊剂含量介于2-6%。针对不同的焊接应用，本公司也生产线径可达到0.15mm的无铅锡线。
- 雅拓来也可为您定制合金，来应用于传统的手工焊，自动焊，以及管道焊接应用。



- Electroloy's solder pastes were manufactured under strict process & controlled environment, resulting in very consistent & quality solder paste.
- Our solder paste comes in low-mid temperature range in different flux type & particle size.
- We provide good technical support in your use of Electroloy's solder paste.
- 雅拓莱的焊膏在严格的流程和控制环境下生产，产品性能稳定，品质优良。
- 我们的焊膏属于中低温范围，具有不同焊剂类型和颗粒尺寸。
- 在您使用雅拓莱的焊膏时，我们将提供优秀的技术支持和服务。

详情请咨询

深圳市俊基瑞祥科技有限公司 (0755-82282821/0755-82281981)

深圳市俊基瑞祥科技有限公司上海分公司 (021-60765250/021-60765253)

俊基瑞祥(香港)科技有限公司 (852-81005996)





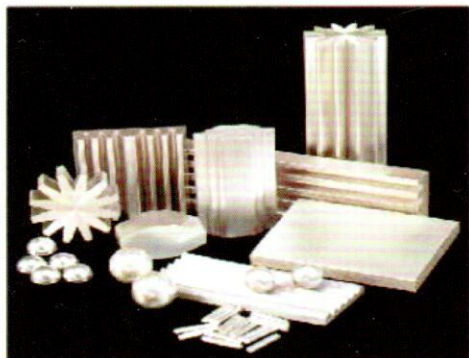
PRODUCT SELECTION GUIDE

产品选择向导



The Ball & button anodes allows for more contact area to bring about greater current efficiency & a more uniform electrical current distribution throughout the basket.
 Better & more uniform deposition of tin on the printed circuit board.

阳极球和阳极扣可提供更大的接触面积，从而获得更高的电导率和更统一的电流分布率贯穿basket。在PCB板上更优良和更一致的锡沉淀。



Electroloy's anodes are process from virgin metal with high purity to ensure low sludging, greater plating process efficiency, less maintenance & lower energy consumption.

Electroloy employ the extruded method to create a product of dense, fine & smaller metal crystals packed into a much tighter crystalline structure.

Result in a better uniform dissolving of the anode & a more even distribution of metallic ions in the plating bath.

雅拓莱无铅阳极棒由高纯度金属制造出来，以确保电镀过程的低泥渣，更高的电镀工艺效率，更少的维持和更低的能量消耗。

雅拓莱运用挤压技术生产，将高密度，微细和更小的金属晶体挤压成非常紧密的晶体结构体。

可使锡阳极棒形成更统一的溶解，在电镀槽里更平整的金属离子分布。



At Electroloy, we are capable to offer custom alloy development for specific temperature requirements and for special applications. Or we can provide an alloy for your specific application that will meet your requirements.

We also made the standard leaded bars 63/37 & others for the automotive industries.

我们雅拓莱公司有能力提供特定温度要求和特别用途的合金。我们也能提供顾客特定用途的合金以达到顾客的要求。我们也可以提供标准的含铅锡条63/37以及用于汽车工艺的其它焊接产品。

详情请咨询 深圳市俊基瑞祥科技有限公司 (0755-82282821/0755-82281981)
 深圳市俊基瑞祥科技有限公司上海分公司 (021-60765250/021-60765253)
 俊基瑞祥(香港)科技有限公司 (852-81005996)

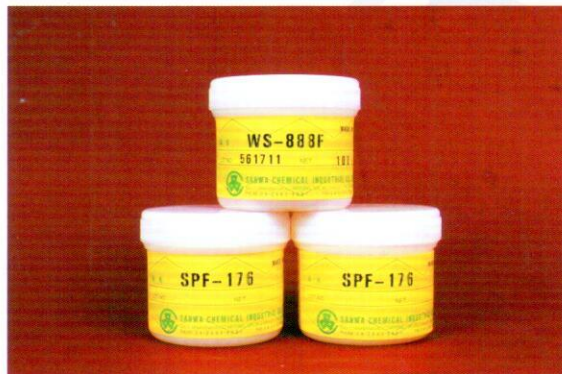




三和化学工业株式会社 SANWA CHEMICAL

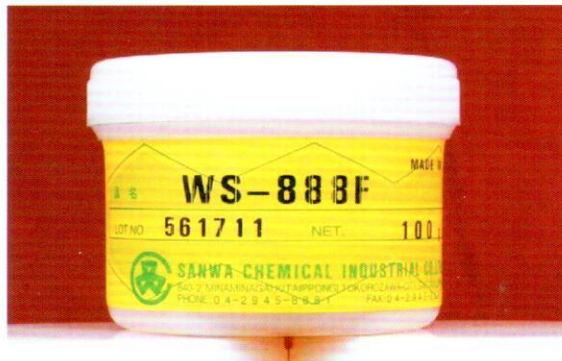
SPF-176

无卤素 BGA 返修助焊膏



WS-888F

维修用水溶性助焊膏



产品一览表

PCB相关产品		电子组装相关产品	
导电性胶	银浆	助焊剂(FLUX)	SRM-800PF
	铜浆		SRM-SF-360 PF-1
	碳膏		SPF-176
助焊剂 (FLUX)	Post flux(水溶性、RMA、超低残留、其它) Preflux	清洁剂	SRM-L2010
	水溶性flux 特殊金属用flux		SRM-L2011

详情请咨询

深圳市俊基瑞祥科技有限公司 (0755-82282821/0755-82281981)

深圳市俊基瑞祥科技有限公司上海分公司 (021-60765250/021-60765253)

俊基瑞祥 (香港) 科技有限公司 (852-81005996)





三和化学工业株式会社 SANWA CHEMICAL



PX801 红胶

适合加强 PCB /移动的连接面积，易于在狭窄区域穿透，具有非常低的粘度



您的专业生产绿色伙伴

SPP-8885WS1L 水溶锡膏及其他免洗锡膏

产品一览表

PCB相关产品		电子组装相关产品	
液态感光油墨 碱性现象型油墨 文字油墨 抗蚀刻油墨 抗电镀油墨	SPSR-900G	有铅锡膏	SSP-2032A (常温保管型) SSP-2032B (常温保管型) SSP-3032A (常温保管型) SSP-3032B (常温保管型) SSP-3032C (常温保管型) SSP-3232A (常温保管型) SSP-3232B (常温保管型) SSP-3232C (常温保管型) SSP-3235A (常温保管型)
	SPSR-950		
SPPR-400			
SPER-100			
FPC软板油墨	SPFR-5200		
	IR-530 FR		
热硬化型油墨 文字油墨 抗蚀刻油墨 抗电镀油墨	FU-5000		
	IR-650G		
	IR-530G		
	IR-650W		
	SM-530W		
	DA-266C		
紫外线硬化型油墨 文字油墨 抗蚀刻油墨 抗电镀油墨	GR-550C	无铅锡膏	SSP-4032S1 (常温保管型) SSP-4032S2 (常温保管型) SSP-4032S3 (常温保管型) SSP-4385S1 (常温保管型) SSP-4382S1 (常温保管型)
	UR-3100G		
	MUV-1000W		
	UE-7000B		
	UE-9000B		
UGR-610B			

详情请咨询

深圳市俊基瑞祥科技有限公司 (0755-82282821/0755-82281981)
 深圳市俊基瑞祥科技有限公司上海分公司 (021-60765250/021-60765253)
 俊基瑞祥(香港)科技有限公司 (852-81005996)





产品描述 Product Description

本公司是无铅焊料的综合生产厂家，完全解决原有铅焊料对环境污染的问题，现专门生产及销售环保型高品质无铅焊料、锡膏、锡条、锡线、锡球、锡片。

Our company is a specialized Pb free Solder Products. Our main products are all forms of environment friendly Pb Free EF Solder Products. Halogen Free Products such as Cream, Bar, Wire, BGA Ball and Preform Solder products that solve a problem of environment pollution by using the existing Pb Solder.



合金成分表 Solder Alloy Composition

品名 Product No.	合金成份 Alloy composition	熔融温度 Melting point (°C)		形状 Form				
		固体 Solidus	液体 Liquidus	Cream	Bar	Wire	Ball	Preform
2C20	Sn2Cu(a)	227	268		○			
4C20	Sn4Cu(a)	227	353		○			
4S40	Sn4Sb2.5Cu(a)	232	312		○	○		
2C07	Sn0.7Cu(a)	227	227		○	○		
3N06S	Sn0.5Cu0.06Ni(a)	220	229		○	○		
2N06	Sn0.06Ni(a)	230	233		○	○		
2A30	Sn3Ag(a)	217	220		○	○		
3A10	Sn1.0Ag0.5Cu	221	225	○	○	○		○
3A03	Sn0.3Ag0.7Cu	221	227	○	○	○		
4A03	Sn0.3Ag0.7Cu(a)	221	227		○	○		
2A35	Sn3.5Ag	221	221	○	○	○	○	
2S50	Sn5Sb	232	240	○	○	○		○
3C05	Sn3Ag0.5Cu(a)	217	217	○	○	○	○	○
5C05	Sn3Ag0.5Cu(aβ)	217	217	○	○	○		
5A35	Sn3.5Ag0.5Cu(Ni,Ge)	217	217	○	○	○		
3Z80	Sn8Zn3Bi	191	191	○	○			
4B10	Sn2.5Ag0.4Cu1Bi	214	221	○	○			
4B20	Sn2.5Ag0.4Cu2Bi	215	216	○	○		○	
4B30	Sn2.5Ag0.4Cu3Bi	214	216	○	○			
3B35	Sn35Bi1Ag	139	186	○	○			
4I20	Sn2.5Ag3Bi2In	195	204	○				
2B58	Sn58Bi(1Ag)	139	139	○				

※除以上标准产品之外，可根据使用的用处与焊料的说明定做生产及供应。





EF无铅锡膏系列特征(Pb Free EF Solder Cream Series)

- ▶ 气泡极少产生
- ▶ 高可靠性
- ▶ 免清洗, 无氯, 无臭的环保型锡膏
- ▶ 适合于印刷和滴注的各种类型锡膏
- ▶ Minimal void generation
- ▶ High reliability cream
- ▶ Halogen Free, no cleaning, no chlorine and no foul smell
- ▶ Various type cream for printing and bumping

EF SOLDER CREAM



产品名称(Product Name)

E F C - 3 C 0 5 - 3 0 - M
 Classification by Alloy composition Powder Flux Type
 Product Form Granularity

印刷用锡膏(Solder Cream for printing)

品名 Product No.	焊料种类 Solder Class	焊料成分 Solder Composition	熔点(°C) Melting Point(°C)	焊接温度(°C) Soldering Temp.(°C)	特征 Features
3C05	Sn-Ag System	Sn3Ag0.5Cu(a)	217/217	235±5	<ul style="list-style-type: none"> ▶ High reliability ▶ Excellent Corrosion Resistance and Spreadability ▶ Minimum Void
5A35		Sn3.5(3)Ag0.5Cu(Ni.Ge)	217/217		
3A10		Sn1Ag0.5Cu	220/225		
3A03		Sn0.3Ag0.7Cu	220/227		
4B20	Sn-Ag System (Adding Bi.In)	Sn2.5Ag0.4Cu2Bi	215/216	230±5	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Excellent Spreadability and Bondability ▶ Possible to apply Phenol substrate
4I20		Sn2Ag3Bi2In	195/204		
3B35	Sn-Bi System	Sn35Bi1Ag	139/186	220以下	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Possible to joining in low temperature ▶ Possible to joining in low temperature ▶ Low cost
2B58		Sn58Bi(1Ag)	139/139	220以下	
2S50		Sn5Sb	232/240	265±5	

点滴式锡膏(Solder Cream for Dispenser)

分类 Classification	产品名 Solder Class	合金组成 Solder Composition	熔点(°C) Melting Point(°C)	特征 Features	粉末间隙(μm) Powder Granularity
EF Solder	EFD-2S50	Sn5Sb	232/240	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Good continuous printability ▶ Excellent Preservation property ▶ Minimum change of viscosity for aging time ▶ Countermeasure for high temperature 	15~25μm 20~32μm 20~38μm 20~45μm
	EFD-2A35	Sn3.5Ag	217/217		
	EFD-3C05	Sn3Ag0.5Cu(a)	217/217		
	EFD-5A35	Sn3.5Ag0.5Cu(Ni,Ge)	217/217		
	EFD-3A10	Sn1Ag0.5Cu	220/225		
	EFD-3A03	Sn0.3Ag0.7Cu	220/227		
	EFD-2B58	Sn58Bi(1Ag)	139/139		

泵压式锡膏 (Solder Cream for Bumping)

分类 Classification	产品名 Solder Class	合金组成 Solder Composition	熔点(°C) Melting Point(°C)	特征 Features	粉末间隙(μm) Powder Granularity
Micro Printing Micro Dispensing	EFC-2A35-B	Sn3.5Ag	217/217	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Excellent continuous workability ▶ Excellent mechanical property of micro bumping soldering part ▶ Excellent reliability of micro bumping soldering part 	5~20μm 5~15μm 3~7μm
	EFC-3C05-B	Sn3Ag0.5Cu(a)	217/217		
	EFC-5A35-B	Sn3.5Ag0.5Cu(Ni,Ge)	217/217		
	EFC-3A10-B	Sn1Ag0.5Cu	220/225		
	EFC-3A03-B	Sn0.3Ag0.7Cu	220/227		





PK

- ▶ 把氧化锡变成有用金属的魔术液
- ▶ 新配方-更容易使用
- ▶ 新的配方可还原更多氧化锡
- ▶ M·E·T·A·L
- ▶ Covered by U.S.and
- ▶ Global Patents

获美国和全球专利

减少70-85%的焊锡采购量

使用方便并不含有害物

全球供应

可选在线或离线工艺

可提供DIY配件



在当今激烈竞争的形势下，精明的公司都在竭尽全力的降低损耗，节省成本。

Ms2锡渣还原剂正好胜任此职，它能够对锡渣做还原处理，变废为宝。

请莫迟疑！马上跟我们联系，进行免费的现场评估！

详情请咨询

深圳市俊基瑞祥科技有限公司 (0755-82282821/0755-82281981)

深圳市俊基瑞祥科技有限公司上海分公司 (021-60765250/021-60765253)

俊基瑞祥(香港)科技有限公司 (852-81005996)





MS-2锡渣离线还原机

- ▶ 高还原率
- ▶ 特设过热保护措施，保证设备和人员安全
- ▶ 超大抽风口设计，大大改善操作环境
- ▶ 炉胆采用耐高温、防腐蚀进口钛合金
- ▶ 机器安装、操作、维护简单可节约人手



机型	锡渣离线还原机
电源规格	AC220V±10%50/60Hz
功率	6300W
外形尺寸(突出部位除外)	L1000×W825×H1300mm
炉胆尺寸	L450×W260×150mm
锡缸容量	约200KG约350KG
主机重量	约180KG约260KG
材质	纯钛合金
抽风口直径	100mm



CKSC®

深圳市俊基瑞祥科技有限公司

SHENZHEN CHUN KEI SHUI CHEUNG TECHNOLOGY CO.,LTD

深圳市俊基瑞祥科技有限公司上海分公司

SHENZHEN CHUN KEI SHUI CHEUNG TECHNOLOGY CO.,LTD SHANGHAI BRANCH

俊基瑞祥(香港)科技有限公司

CHUN KEI SHUI CHEUNG (HK) TECHNOLOGY LIMITED

地址：深圳市罗湖区南湖街道建设路东方广场1栋1807

电话：0755-82282821 传真：0755-82283686

网址：www.sz-cksc.com



www.sz-cksc.com